

科技部 函

地址：台北市和平東路2段106號
聯絡人：郭天舜 科長
電話：02-2737-7285
傳真：
電子信箱：tskuo@most.gov.tw

受文者：國立政治大學

發文日期：中華民國107年3月13日
發文字號：科部工字第1070018269號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明四(107E0P000047_107D2006371-01.doc、107E0P000047_107D2006373-01.doc、107E0P000047_107D2006372-01.docx)

主旨：本部工程司推動107年度「積層製造(數位製造)產業應用研究專案計畫」，自即日起接受申請，請查照轉知。

說明：

- 一、本計畫申請及審查包含「構想書」及「計畫書」兩階段；申請人應於107年4月23日(星期一)前，將構想申請書電子檔E-mail至本部工程司聯絡人信箱；構想書獲審查推薦者，請申請人依本部補助專題研究計畫作業要點，研提正式計畫申請書(採線上申請)；申請人之任職機構應於107年6月22日(星期五)前函送本部，逾期不予受理。
- 二、本公告獲補助計畫需配合本部進行期中、期末成果追蹤、查核及考評，未獲補助案件恕不受理申覆。
- 三、本公告未盡事宜，應依本部補助專題研究計畫作業要點、本部補助專題研究計畫經費處理原則及其他相關法令規定辦理。
- 四、本專案計畫徵求公告如附件，計畫相關申請規範與研究範疇等請詳參公告內容。相關訊息另公布於本部網站(<http://>



//www.most.gov.tw/)-動態資訊(計畫徵求)或工程司網站
(https://www.most.gov.tw/eng/ch)-公告事項

五、有關係統操作問題，請洽本部資訊系統服務專線，電話：
0800-212-058，(02)2737-7590、7591、7592。

正本：專題研究計畫受補助單位（共304單位）

副本：本部綜合規劃司、工程司(均含附件)

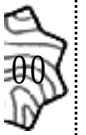


部長陳良基

裝



訂



線